

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2026-042

希荻微电子集团股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.（以下简称“香港希荻微”）	80,000 万元	20,000 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
深圳市诚芯微科技有限公司（以下简称“诚芯微”）	20,000 万元	0	不适用：本次为年度担保预计	否
合并报表范围内的其他子公司	20,000 万元	0	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	60,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	40.33
特别风险提示	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、申请综合授信额度情况概述

根据公司 2026 年度经营及投资计划的资金需求，公司及子公司预计在 2026 年度向银行等金融机构申请合计不超过 18 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，授信品种包括但不限于固定资产贷款、项目贷款（含并购贷款等）、抵押贷款、流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、银行保函、国内外贸易融资等综合授信业务。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或续约，也包括已签订尚在合同有效期内的授信期超过 12 个月的长期授信。上述授信事项的授权有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年，授信额度在有效期内可循环使用。

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供连带责任担保，担保额度预计不超过人民币 12 亿元或等值外币。该担保额度可在公司合并报表范围内的全资子公司（包含公司后续设立或收购的公司）之间进行调剂。

上述担保事项的授权有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年，担保额度在有效期内可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士根据实际经营情况需求在上述授信及担保额度范围内具体执行并签署相关文件，办理相关手续等，并在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

上述授信及担保额度不等于公司实际融资及担保金额，实际授信及担保额度最终以银行等金融机构最后审批的授信及担保额度为准，具体融资及担保金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资及担保期限以实际签署的合同为准。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担	被担	担 保	被担保	截至目	本次新	担保额	担保预	是	是否
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	----

保方	保方	方持	方最	前担	增担	度占	计有效	否关	有反
	方	比	近一	保	保	上	期	联	担
	股		期资	额	额	市		担	保
	例		产负	(万	(万	公		保	
			债	元)	元)	司			
			率			最			
						近			
						一			
						期			
						净			
						资			
						产			
						比			
						例			
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
希 荻 微	香港 希荻 微	100%	40.17%	20,000	80,000	53.78%	自 2025 年年度 股东会 审议通过 之日起 一年有 效。具 体担保 期限以 实际签 署的合 同为准	否	否
	诚芯 微	100%	35.83%	不适用	20,000	13.44%		否	否
	合并 报表 范围 内的 其他 子公 司	100%	-	-	20,000	13.44%		否	否

(四) 担保额度调剂情况

上述担保额度可以在公司各级全资子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1. Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.

被担保人类型	法人
被担保人名称	Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	希荻微持股 100%
成立时间	2013 年 10 月 4 日
注册地	中国香港

股本情况	已发行股份数为 90,001,300 股普通股		
经营范围	集成电路模拟芯片的物流、采购和销售等，系希荻微主营业务的组成部分		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（未经审计）
	资产总额	99,060.97	100,874.26
	负债总额	39,789.18	39,360.28
	资产净额	59,271.79	61,513.98
	营业收入	90,934.19	53,654.19
	净利润	-6,014.74	-9,449.41

注：上述香港希荻微财务数据为香港希荻微合并范围数据。

2. 深圳市诚芯微科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	深圳市诚芯微科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	希荻微持股 100%		
成立时间	2009 年 12 月 23 日		
注册地	广东省深圳市		
注册资本	3,026.25 万人民币		
经营范围	一般经营项目：集成电路、IC、三极管的设计、研发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，不含进口分销）。许可经营项目：无。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	19,756.31	22,635.52
	负债总额	7,078.39	12,372.16
	资产净额	12,677.93	10,263.36
	营业收入	19,666.54	19,746.31

	净利润	2,414.56	2,170.89
--	-----	----------	----------

注：上述诚芯微财务数据为诚芯微合并范围数据。

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期内的除外）。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对被担保人具有绝对的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信的额度及担保预计事项符合公司及子公司正常生产经营的需要，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东的利益。

综上，董事会同意《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 6 亿元人民币，全部为公司对子公司提供的担保（不含本次的担保），上述金额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 40.33%、32.40%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年4月17日